

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	易方达基金、兴证全球、博时基金、中信建投等多家机构
时间	2024年04月30日 10:00-11:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：赵奇 财务负责人、董事会秘书：王伟 副总经理：张霞 芯联动力董事长：袁锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司领导介绍一季度经营情况等：</p> <p>今年第一季度，公司明显感受到了市场需求的复苏，产线开工率在稳步的提升中。公司继续深耕新能源、智能化市场，坚持技术创新和精益经营，实现了收入的稳定增长，以及净利润同比的大幅减亏。2024年一季度，公司实现营业收入13.53亿元，同比增长了17.2%；经营性现金流净额达到3.06亿元，同比增长了40.68%；实现EBITDA 4.82亿元，同比增长112%。由于收入的增长、成本控制和成本改善措施的推进，一季度公司归母净利润为-2.42亿元，同比减亏2.57亿元。</p> <p>为了达到营收持续增长和净利润大幅减亏的目标，公司重点从以下几个方面推动：</p> <p>第一，加速产品迭代，实现产品结构持续优化。</p> <p>依托完整的产品应用布局，2024年公司加速产品迭代，持续推出更高性价比的产</p>

品, IGBT、SiC、MEMS等产品市场份额持续提升。

第二, 车载功率模块装机量同比增长超过8倍, SiC出货量保持国内第一。

根据NE时代统计的新能源乘用车功率模块装机量, 公司第一季度功率模块装机量近28万个, 位列行业第四名, 同比增速超850%。

作为国内稀缺的实现了SiC MOS主驱逆变器规模量产的企业, 公司一季度SiC MOS满载生产, 产量持续提升, 产品保持高良率、高品质, 收入环比继续增长。

全新一代车载IGBT芯片和多款SiC模块已通过客户端验证, 开始进入规模客户导入和量产阶段。

第三, 模拟IC获得重大突破, 多个模拟高压平台进入量产。

公司BCD专注在高电压、大电流、高可靠性的车载和工业应用上, 已经完整搭建覆盖车载、工控、消费类的驱动、电源和信号链多个平台, 客户覆盖国内外众多头部IC客户, 涵盖汽车、新能源和高端消费类等领域。

一季度公司多个模拟高压平台进入量产; 嵌入式集成功率器件在车载高低边开关应用广泛推广, 获得多个客户定点; 发布了高压BCD平台, 嵌入式数模混合控制BCD平台获得国内重要终端车厂定点。公司已通过全球知名汽车Tier1车规IC审核, 获得最高等级A级认证, 优异的产品品质获得客户认可。

第四, 消费电子市场持续回暖, 消费业务收入占比提升。

公司是国内最大的MEMS制造基地, 高性能MEMS麦克风产品已完成国际头部终端的认证, 平台和产品都在不断丰富和完善中, 手机锂电池保护芯片实现大批量的国产替代。

公司研发出全系列智能功率模块产品, 产品应用覆盖绿色智能家电, 已经开始批量生产。受益于消费市场的持续回暖, 公司一季度消费业务收入同比实现翻倍增长。

第五, 导入多款工控产品, 持续满足风光储头部企业的应用需求。

针对风光储市场, 公司结合终端多款新机型应用需求, 获得多个光储头部客户最新平台的项目定点, 如大功率光伏逆变产品, 大功率储能PCS产品; 推出面向高压大功率风电的高功率产品; 为全球风光储头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体IGBT, SiC芯片及模块。

第六, 高研发投入和新客户导入加速, 技术创新驱动未来成长。

一季度, 公司研发费用4.70亿元人民币, 同比增长36.32%, 占营业收入的34.75%。研发投入增长主要是公司12英寸产线、SiC MOSFET、模组等项目研发投入增加所致。

这些研发成果带动了公司在一季度导入50家以上新客户, 客户覆盖了汽车领域的国内外主机厂和Tier1, 以及风光储、家电领域等行业头部, 为未来的收入快速增长奠定了基础。

展望未来, 随着半导体行业的持续复苏, 公司将加速产品迭代和推动新产品量产。车载应用方向: 持续提升SiC产能, 扩大市场领先优势, 快速推进模拟IC在客户的量产

应用；消费应用方向：推动AI手机、家电、笔电市场的产品导入；工控市场应用方向：全面推动风光储网算5个方向产品布局和市场渗透。同时，公司进一步加强技术创新、工艺改进和降本增效，全力推动收入持续稳健增长，实现净利润大幅减亏的目标。

二、现场交流：

问题1：目前公司SiC业务领先业内，公司SiC业务收入增长来自哪些客户和车型的重大定点？公司SiC业务大概达到多少规模可以实现盈利？

回复：公司一直秉持技术市场双轮驱动策略。一方面持续对已经居于国际前列的器件进行迭代，8英寸SiC产线建设进展顺利，计划四季度开始正式向客户送样，2025年进入规模量产，以保证SiC产品一直保持国际先进的技术和成本优势。另一方面不断加深国内外终端车厂和tier1系统厂商合作，获取重点客户定点，同时引入更多的产业上下游联合深入合作。

问题2：公司12寸BCD业务用于开发模拟芯片，如何看待模拟IC市场的竞争情况？公司模拟IC的差异化竞争优势有哪些？预计收入增长主要来自哪里？

回复：模拟IC赛道宽广，产品丰富。在车规和工业级大电流高电压BCD方向上，一直存在技术复杂、应用门槛高、国产替代比例非常低的情况。过去3年多，公司持续开发了10多个专用BCD平台，定向瞄准了一系列持续增长和供应稀缺的应用产品，拥有国内独有的技术。目前，公司已经取得技术和市场的双突破，为公司收入的增长和利润成长带来强劲动力。

在消费类应用方向，公司推出具有极强通用性的消费类BCD技术，增强公司在研发和生产成本上的优势，为公司营收成长持续贡献。

据统计，BCD全球市场400亿美元，中国消费占有一半，但国产化率不到10%。公司利用对市场应用的深入理解，对BCD、嵌入式数字技术和嵌入式功率器件的融合技术优势，联合国内外优秀设计公司和终端应用，共同进行产品和技术的研究开发。智能化新能源车车身架构的进一步发展和AI超大计算中心的建设将会为公司BCD业务的发展提供持续动力。

问题3：公司今年计划减亏，很高兴看到目前公司亏损在收窄，有什么措施保证全年实现减亏目标吗？根据股权激励计划考核目标，公司2026年收入达到约100亿元，请问净利率能达到多少？

回复：2024年实现大幅减亏是公司明确的目标，我们主要从两个方面入手来实现这一目标。

第一个方面是不断通过技术迭代和技术创新，实现技术的领先性和丰富化，并在这些领先和丰富的技术上实现更大的生产规模，贡献更大的营收。比如通过产品迭代，全

球领先的新一代IGBT器件将在下半年进入量产，大幅提高同一晶圆上的芯片产出数量，从而实现营收的增长。通过SiC芯片和模组、模拟IC、VCSEL等新技术、新产品的上量等实现营收的增长。积极快速响应市场，扩大市场份额，提升产能利用率，增加营收。

第二方面是不断优化公司的成本结构：(1)通过工艺步骤、工艺条件的优化来降低工艺平台的基础成本；通过生产效率的不断提升来降低单步工艺的成本；(2)通过供应链上的战略合作和协同，公平竞争等，来降低材料和零部件的采购成本；(3)通过精细化管理和信息数据、流程的系统化，设备的自动化等，来提高人员的工作效率、降低库存资金占用、减少各个方面的浪费。

通过以上开源、节流两个方面的努力，公司对2024年实现大幅减亏充满信心。

公司员工股权激励计划中，2026年员工股权激励实现的业绩目标是营业收入达到100亿元，同时努力实现公司整体盈亏平衡。

问题4：硅基功率器件市场竞争激烈，公司如何看待？在IGBT、MOS上的竞争策略是什么？

回复：从去年四季度以来，消费类低压MOS市场持续复苏，同时新能源车的国产化率进一步提升。由于公司在IGBT产品技术、成本、质量的优势，目前国内车规级IGBT订单进一步向公司集中。光伏市场目前也有了明显的复苏。

公司坚持技术和市场双驱动，持续迭代MOS和IGBT器件技术，提高性价比、持续研发和渗透门槛更高的大功率高电压模块市场（比如光伏大型地面站和风电）、系统地组织我们硅基功率器件、SiC产品和专用BCD整体方案去攻占市场和增加客户黏性。

从应用方向来看，工业和消费类市场仍将长期使用硅基的IGBT产品。公司已加大了对工业和消费类IGBT研发和市场开拓的努力。此外，在车载应用领域，细分车型越来越强调性价比，公司极具成本竞争力的IGBT和硅/SiC融合技术会在车的应用里具有长期的生命力。

问题5：公司一季度研发开支占比35%，能解释一下都用在了哪些方面吗？

回复：随着市场需求的复苏，为了能迎接旺盛的市场需求阶段，获得和巩固更多中、高端技术及产品的市场份额，公司继续在12英寸车规级BCD平台、SiC MOSFET、功率模组等方面保持足够的研发投入强度。

在车载领域，高压BCD、嵌入式数模混合控制BCD等平台发布，全新一代车载IGBT芯片和多款SiC的模块已在客户端验证通过，开始大规模客户导入和量产起量；

风光储充等工控方向上，结合终端多款新机型应用需求，公司研发并导入了多款产品，如大功率光伏逆变产品，大功率储能PCS产品和面向高压大功率风电的高功率产品，为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体IGBT，SiC芯片及模块；

在家电应用领域，研发出全系列智能功率模块产品，产品应用覆盖绿色和智能家电，已经开始批量生产。

这些研发成果带动公司在今年一季度新客户导入50家以上，客户覆盖从汽车领域的国内外主机厂和Tier1，以及风光储、家电领域等行业头部，并为未来的收入快速增长奠定了基础。

问题6：模拟IC下游市场竞争激烈，公司对于模拟IC平台和产品盈利性的展望？

回复：模拟IC市场目前的国产化率还不到10%，留给公司的发展空间还是巨大的哦。公司模拟IC产品主要为大电流、高电压的产品，其价值较高。目前，公司产品已实现大量导入，同时与应用端充分结合，获得Design-in和Design-win。

当前国内有生产的BCD主要集中在40V以下消费类通用型产品，而公司聚焦于高电压、大电流产品，目前高电压、大电流产品国内还主要依赖进口。

另一方面，公司的模拟IC还提供多种集成化工艺平台，随着国内新能源汽车、风光储终端从全球的跟随者逐渐发展为引领者，这些终端提出来的BCD嵌入数字电路、BCD嵌入功率器件等的集成化方案，在全球也都是新开发方向，具有前沿性、稀缺性。

问题7：公司各个平台的产能情况？

回复：目前，公司8英寸硅基已达月产17万片（其中IGBT月产8万片，MOSFET月产7万片，MEMS月产1.5万片以及HVIC月产0.5万片），通过效率提升、工艺调整，8英寸硅基产线的产能可视市场需求进一步提升；SiC MOS当前月产能5000片，产量饱满，计划今年扩产到1万片/月；公司12英寸2023年年底已实现月产能1万片，今年计划进一步扩大到月产能3万片，70%应用于BCD，30%应用于IGBT/MOSFET产品。

问题8：车用器件，降价压力大，一季度看，环比去年四季度，降价幅度如何，今年展望？会不会有持续降价压力？公司成本端下降能不能覆盖车厂降价需求？

回复：公司一季度的平均售价没有下降，2023年公司的平均售价略有上升。公司将通过技术迭代，提供更有性价比的产品，例如通过技术升级来提高功率密度，单片晶圆上可以切更多的die，die的单价有所下降，但单片晶圆价格稳定甚至上升。

问题9：公司有什么核心优势？

回复：首先，在商业模式上，公司为客户提供一站式系统代工服务。公司的商业模式，以晶圆代工为起点，向上延伸到设计服务，向下延伸到模块封装、应用验证、可靠性测试等，可以满足不同客户的各种需求；

其次，通过研发的强投入，公司的技术平台更具有稀缺性、竞争性。一方面在国内稀缺，大量依靠进口的产品方面，我们开发出了量产化的技术平台，如SiC MOS、高压

	<p>大电流BCD等等。另一方面在国内非稀缺的产品方面，我们开发出了更具性价比的技术平台；</p> <p>再次，公司具有先发优势。公司从2018年进入新能源汽车芯片，是国内新能源领域渗透最早、规模最大的企业。目前，公司已与国内90%的终端结合在一起。更重要的是，公司持续投研发，不断补短板，做好长板，公司与终端客户共同做技术和解决方案的创新，比如BCD集成MCU、BCD集成功率器件等，实现Design-in。</p> <p>问题10：公司在国内属于最先进的IGBT企业之一，与国际厂商相比，IGBT处于什么位置？另外，SiC在汽车上的应用趋势怎么展望？</p> <p>回复：国内的新能源汽车、光伏终端已经是全球第一梯队。公司的IGBT技术已比肩国际头部客户，主驱逆变IGBT的技术指标同国际无差别，甚至由于公司和应用端配合的更紧密，可能会有最新产品早于国际同行发布。公司围绕应用需求进行定向开发，在光伏大功率新机型上是第一梯队进行design-in的，在大功率应用领域没有代差，基于和头部终端客户的良好互动，在局部领域公司会更加领先。</p> <p>SiC上，公司已经在量产的是G1代产品，其核心技术指标已比肩国际当前的水平；2023年公司陆续推出G1.5代、G1.7代，G1.5代技术性能相比G1提升20%，G1.7比G1.5提升20%；沟槽产品的研发也已接近尾声，进入验证阶段。公司在SiC产品方面已经做好技术储备，未来随着市场需求逐步释放。</p> <p>2024年公司计划实现8寸产线的通线验证，并计划四季度送样，2025年实现8寸量产，进一步取得在生产成本上的优势。同时，芯联动力通过资本纽带联合产业上下游，共同开发、深入合作。预计未来两年，公司SiC业务能保持每年60%以上的增速。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月30日